

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】平成 17 年 9 月 8 日 (2005.9.8)

【公表番号】特表 2001-504720 (P2001-504720A)

【公表日】平成 13 年 4 月 10 日 (2001.4.10)

【出願番号】特願 平 10-522314

【国際特許分類第 7 版】

A 6 1 J 3/06

A 6 1 K 9/02

A 6 1 K 9/70

B 0 1 J 2/00

B 0 5 C 19/00

B 0 5 D 7/00

【F I】

A 6 1 J 3/06 M

A 6 1 K 9/02

A 6 1 K 9/70

B 0 1 J 2/00 B

B 0 5 C 19/00

B 0 5 D 7/00

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 12 月 15 日 (2004.12.15)

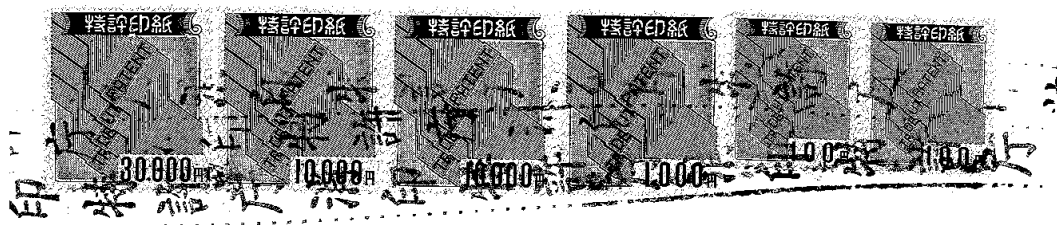
【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】



手 続 補 正 書

(¥51,200)

平成16年12月15日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第522314号



2. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

名 称 フオカス リミテッド

3. 代 理 人

居 所 〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号

新 大 手 町 ビ ル デ ィ ング 3 3 1

電 話 (3 2 1 1) 3 6 5 1 (代 表)

氏 名 (6 6 6 9) 浅 村

皓



4. 補正により増加する請求項の数

32

5. 補正対象書類名

請求の範囲

6. 補正対象項目名

請求の範囲

7. 補正の内容 別紙のとおり



方 式 査



請 求 の 範 囲

1. 基体に、生物活性のある物質を含んで成る活性なコーティング材料を静電的に粉体として適用して、該基体から除去可能な活性コーティング層を形成する工程を含む、基体のコーティング方法。
2. 活性コーティング層の適用後に、活性コーティング材料を融着させて基体の表面に活性フィルムコーティングを形成する工程をさらに含む、請求の範囲第1項に記載の方法。
3. 各固体剤形を提供するために、活性コーティング層が基体から取り除けるものである、請求の範囲第1項または第2項に記載の方法。
4. 基体に適用される活性コーティング中の活性物質の量が、活性物質の1用量と実質的に同じである、請求の範囲第1項または第2項に記載の方法。
5. 基体の所定区域上に付着される活性コーティング材料の量を、該活性コーティングがその後で複数の部分に分割できるように制御し、この場合各々の部分は各々所定量の該活性コーティング材料を含み、各所定量が生物活性のある物質の1用量である、請求の範囲第1項または第2項に記載の方法。
6. 活性コーティングを複数の部分に分割し、各部分が生物活性のある物質の1用量を含む、請求の範囲第5項に記載の方法。
7. 活性コーティング層を複数の部分に切断する、請求の範囲第1項または第2項に記載の方法。
8. 活性コーティング材料を、基体の表面の複数の各々の領域に適用する、請求の範囲第1～6項のいずれかに記載の方法。
9. 基体からその活性コーティングを取り除く工程を含む、請求の範囲第1～8項のいずれかに記載の方法。
10. 基体からその活性コーティングを取り除いてカシュ剤を形成し、該カシュ剤を切断して各カシュ剤部分が実質的にある一定用量の生物活性のある物質を含んでいる複数のカシュ剤部分を形成する、請求の範囲第5項に記載の方法。
11. コーティング装置の1つの表面に活性物質を適用し、活性コーティングをカシュ剤として取り除く、請求の範囲第9項または第10項に記載の方法。
12. コンベヤーベルトに活性物質を適用する、請求の範囲第11項に記載

の方法。

13. 基体がテープである、請求の範囲第1～第10項のいずれかに記載の方法。

14. 基体がプラスチック材料を含んで成る、請求の範囲第1～第10項のいずれかに記載の方法。

15. 活性コーティング層の上に被覆コーティング材料を、該活性コーティング層が被覆コーティング層で実質的に完全に覆われるように、また該被覆コーティング層が基体から取り除けるように適用して、該被覆コーティング層を形成する工程をさらに含んでいる、請求の範囲第1～第14項のいずれかに記載の方法。

16. 被覆コーティング層を活性コーティング層の複数の露出した表面に適用すること、およびコーティングされた基体を分割して各基体部分が生物活性のある物質の実質的に1用量を含む複数の基体部分を形成することを含んでいる、請求の範囲第1～第14項のいずれかに記載の方法。

17. 被覆コーティング材料を静電的に適用する、請求の範囲第15項または第16項に記載の方法。

18. 被覆コーティング材料を粉体として適用する、請求の範囲第15～第17項のいずれかに記載の方法。

19. 被覆コーティング層の適用後に、被覆コーティング材料を融着させて被覆フィルムコーティングを形成する、請求の範囲第18項に記載の方法。

20. 被覆コーティング層が予め成形されたフィルムまたはシートである、請求の範囲第19項に記載の方法。

21. 被覆コーティング層は活性コーティング層とともに取り除けるものである、請求の範囲第15～第20項のいずれかに記載の方法。

22. 被覆コーティング層は活性コーティング層とは別に取り除けるものである、請求の範囲第15～第20項のいずれかに記載の方法。

23. 被覆コーティング層が活性コーティング層中の生物活性のある物質の徐放を提供する、請求の範囲第15～第22項のいずれかに記載の方法。

24. 被覆材料が生物活性のある物質を含み、活性コーティング材料中の生

物活性のある物質と被覆コーティング材料中の生物活性のある物質が同一である、請求の範囲第15～第23項のいずれかに記載の方法。

25. 被覆材料が生物活性のある物質を含み、活性コーティング材料中の生物活性のある物質と被覆コーティング材料中の生物活性のある物質が異なる、請求の範囲第15～第23項のいずれかに記載の方法。

26. 活性コーティング材料を基体の1つの表面の一部に適用する、請求の範囲第1～第25項のいずれかに記載の方法。

27. 活性コーティング材料の上に被覆コーティング層を、該活性コーティングが該被覆コーティングで実質的に完全に覆われ、基体の表面を一部のみ被覆するように、また該被覆コーティングが基体から取り除けるように適用して、該被覆コーティングを形成する工程をさらに含んでいる、請求の範囲第26項に記載の方法。

28. 基体の表面の複数の活性コーティング領域に、活性コーティング材料を適用し、複数の被覆コーティング領域を形成するように、被覆コーティング材料を適用し、該活性コーティング領域が各々該被覆コーティング領域で実質的に覆われるようになっており、ここで活性コーティングおよび被覆コーティングのそれぞれの領域は該基体表面から取り除けるようになっている、請求の範囲第27項に記載の方法。

29. 活性コーティング材料の上に被覆コーティング材料を、該活性コーティングが該被覆コーティングで実質的に完全に覆われ、基体の表面全体を被覆するように、また該被覆コーティングが基体から取り除けるように適用して、該被覆コーティングを形成する工程をさらに含んでいる、請求の範囲第26項に記載の方法。

30. 被覆コーティング材料を適用することに加えて、基体の1つの表面に更なるコーティング材料を適用して、基体から取り除けるような更なるコーティング層を形成する工程をさらに含んでいる、請求の範囲第15～第29項のいずれかに記載の方法。

31. 更なるコーティング材料が生物活性のある物質を含み、更なるコーティング層が更なる活性コーティング層を形成する、請求の範囲第30項に記載の

方法。

32. 更なる活性コーティング層の上に更なる被覆コーティング層を、該更なる活性コーティング層が該更なる被覆コーティング層で実質的に完全に覆われるように、そして該更なる被覆コーティング層が基体から取り除けるように適用して、該更なる被覆コーティング層を形成する工程をさらに含んでいる、請求の範囲第31項に記載の方法。

33. 更なる活性コーティング層中の生物活性のある物質が第一活性コーティング層中の生物活性のある物質と異なる、請求の範囲第32項に記載の方法。

34. 第一活性コーティング層を被覆する被覆コーティング材料が、更なる活性コーティング層を被覆する被覆コーティング材料と異なるために、第一活性コーティング層からの第一の生物活性のある物質の放出速度が更なる活性コーティング層からの第一の生物活性のある物質の放出速度と異なる、請求の範囲第33項に記載の方法。

35. 更なる活性コーティング層中の生物活性のある物質が第一活性コーティング層中の生物活性のある物質と同一で、複数の被覆コーティング材料が同一である、請求の範囲第32項に記載の方法。

36. 1種または複数の被覆コーティング材料が生物活性のある物質を含む、請求の範囲第32～第35項のいずれかに記載の方法。

37. 基体に1つを超える活性コーティング層を適用する方法にして、第二活性コーティング層の上に第二被覆コーティング層を、該第二活性コーティング層が該第二被覆コーティング層で実質的に完全に覆われるように適用して、該第二被覆コーティング層を形成する工程をさらに含み、この場合該第二被覆コーティング層は該第一被覆コーティング層から実質的に隔たっており、また基体から取り除けるようになっている、請求の範囲第16～第36項のいずれかに記載の方法。

38. 1つまたは複数のコーティング層で基体を予めコーティングする、請求の範囲第1～第37項のいずれかに記載の方法。

39. 基体上に予めコーティングされたコーティング層が該基体から取り除けるようになっており、活性コーティング層が該コーティング層とともに取り除

けるようになっている、請求の範囲第38項に記載の方法。

40. 基体にベースコーティング層を適用し、該ベース層に活性物質を適用し、該活性コーティング層の上に被覆コーティング層を適用することを含み、該3つの層がともに基体から3層のカシュ剤の形で引き剥がすことで取り除けるようになっている、請求の範囲第39項に記載の方法。

41. ベースコーティング層および被覆コーティング層をそれぞれ粉体として適用し、それぞれ融着してフィルムを形成する、請求の範囲第40項に記載の方法。

42. ベース層および被覆層が活性物質を含まない、請求の範囲第40項または第41項に記載の方法。

43. カシュ剤を基体から取り除き、より小さい複数の部分に分割する、請求の範囲第40～第42項のいずれかに記載の方法。

44. 活性コーティング材料の粒子の少なくとも90重量%が1～45 μm の粒度を有する、請求の範囲第1～第43項に記載の方法。

45. 基体を活性コーティング材料の供給源に隣接する領域を通して搬送し、基体を該活性コーティング材料の供給源に隣接させて支持し、その際該基体の1つの表面が、電位を印加すると該活性コーティング材料が該活性コーティング材料の供給源から該基体に向かって移動し、該基体の1つの表面が該活性コーティング材料でコーティングされるようになるような、該活性コーティング材料の電位とは異なる電位に保持される、請求の範囲第1～第44項のいずれかに記載の方法。

46. 基体为上から支持され、粉体がその供給源から基体の下面に向かって上向きに移動する、請求の範囲第45項に記載の方法。

47. (a) 活性粉体コーティング材料、即ち生物活性のある物質を含む活性コーティング材料の供給源、

(b) 基体を、該活性コーティング材料供給源に隣接して支持するための支持手段、および

(c) 該基体の1つの表面に、該活性コーティング材料を粉体として、該活性コーティング材料が該基体表面に活性コーティング層を形成するように、静電的

に適用する手段を含んで成り、該活性コーティング層が該基体から取り除けるようになっている、基体のコーティング装置。

48. (d) 被覆コーティング材料の供給源、

(e) 活性コーティング層を有する基体を、該被覆コーティング材料供給源に隣接する位置に搬送する手段、および

(f) 該活性コーティング層上に、被覆コーティング材料を、該被覆コーティング材料が該活性コーティング層を実質的に完全に被覆する被覆コーティング層を形成するように、また該被覆コーティング層が該基体から取り除けるように、適用する手段をさらに含んでいる、請求の範囲第47項に記載の装置。

49. 基体がコンベヤーベルトから成る、請求の範囲第47項または第48項に記載の装置。

50. 活性コーティング材料の供給源に電荷を印加する手段を含んでいる、請求の範囲第47～第49項のいずれかに記載の装置。

51. 基体に電荷を印加する手段を含んでいる、請求の範囲第47～第50項のいずれかに記載の装置。

52. 供給源を基体の下方に配置する、請求の範囲第47～第51項のいずれかに記載の装置。

53. 活性粉体コーティング材料を静電的に適用する手段が、該活性粉体コーティング材料を基体の1つの表面の上に適用して、基体の表面から取り除けるようになっている複数の活性コーティング層を含む複数の活性コーティング領域を形成する手段を含み、装置が

(i) 該基体をコーティング材料の供給源に対して移動させる手段、および

(ii) 該基体表面に被覆コーティング材料を適用して複数の被覆コーティング領域を、該活性コーティング領域が各々該被覆コーティング領域で実質的に完全に覆われるように形成する手段を含む、請求の範囲第47～第52項のいずれかに記載の装置。

54. コーティングされた基体、または該基体から取り除かれた活性コーティング層を分割して、各々生物活性のある物質の1用量を含む複数の部分を形成する手段を含んでいる、請求の範囲第47～第53項のいずれかに記載の装置。

55. 生物活性のある物質を含み、コーティングされた基体の表面から取り除けるようになっている、静電的に適用された融着フィルム活性コーティング層を含んで成る、コーティングされた基体。

56. 活性コーティング層が

i) 連続相成分、

i i) 生物活性のある物質、

i i i) 電荷変更成分、および

i v) 流動助剤を含んで成る、請求の範囲第55項に記載のコーティングされた基体。

57. それぞれの固体剤形を提供するために、活性コーティング層がコーティングされた基体の表面から取り除けるものである、請求の範囲第55項または第56に記載のコーティングされた基体。

58. 基体の所定区域上に付着される活性コーティング材料の量を、製品がその後で複数の部分に分割できるようにし、この場合それらの部分は各々所定量の該活性コーティング材料を含み、各所定量が生物活性のある物質の1用量である、請求の範囲第55項または第56項に記載のコーティングされた基体。

59. 基体が請求の範囲第11～第14項のいずれかに記載のものである、請求の範囲第55～第58項のいずれかに記載のコーティングされた基体。

60. 基体の表面に、活性コーティング層を実質的に完全に被覆している被覆コーティング層をさらに含んで成るコーティングされた基体にして、該被覆コーティング層が該基体から該活性コーティング層とともに、または該活性コーティング層とは別に、取り除けるようになっている、請求の範囲第55～第59項のいずれかに記載のコーティングされた基体。

61. 被覆コーティング層が融着フィルム層である、請求の範囲第60項に記載のコーティングされた基体。

62. 被覆コーティング層が請求の範囲第20～第25項のいずれかに記載のものである、請求の範囲第60項または第61項に記載のコーティングされた基体。

63. 請求の範囲第30～第39項のいずれかに記載の1つまたは複数のコ

ーティング層を含む、請求の範囲第60～第62項のいずれかに記載のコーティングされた基体。

64. 活性層がベースコーティング層と被覆コーティング層に挟まれてなり、該3つの層がともに基体から3層のカシュ剤の形で引き剥がすことで取り除けるようになっている、請求の範囲第63項に記載のコーティングされた基体。

65. ベースコーティング層および被覆コーティング層が融着層である、請求の範囲第64項に記載のコーティングされた基体。

66. ベースコーティング層および被覆コーティング層が活性物質を含まない、請求の範囲第64項または第65項に記載のコーティングされた基体。

67. 基体が、基体の表面に複数の活性コーティング領域を形成する複数の活性コーティング層を含んでいる、請求の範囲第55～第66項のいずれかに記載のコーティングされた基体。

68. 各活性コーティング領域が、被覆コーティング材料の層から成る被覆コーティング領域を含み、該活性コーティング領域の各々が該被覆コーティング領域で実質的に完全に被覆されており、各被覆コーティング層が基体から取り除けるものである、請求の範囲第67項に記載のコーティングされた基体。